

附件 1:

武汉市集成电路产业发展若干政策 专项资金管理办法

(修订稿)

第一章 总 则

第一条 根据《武汉市加快集成电路产业高质量发展若干政策》(武政规〔2020〕18号)(以下简称武政规〔2020〕18号文),为促进我市集成电路产业高质量发展,进一步规范财政专项资金管理,充分发挥财政性资金的引导性作用,制定本办法。

第二条 本办法所称专项资金在市支持工业发展专项资金预算中安排,专项资金包括我市集成电路设计企业流片、设计费用补贴(武政规〔2020〕18号文第四、五条),集成电路公共服务平台的建设资助和运营奖励(武政规〔2020〕18号文第六条),集成电路企业销售自主研发设计的芯片及相关产品奖励(武政规〔2020〕18号文第七条),集成电路企业用于研发、生产的贷款贴息(武政规〔2020〕18号文第九条)。

第三条 资金管理遵循公正公平、规范合法、权责对等、有效监督的原则;以标准明确、过程透明、效率效益为目标,按年度实施事后奖补;更加注重依托专业机构,发挥区级经信部门贴近基层、熟悉企业、了解情况的优势,实行市级统筹与分级使用相结合,广泛接受社会监督。

第二章 支持对象和领域

第四条 本办法所称集成电路企业，是指在我市设立的主营业务为集成电路设计、制造、封测、设备、材料的企业，并同时符合下列条件：

（一）在我市登记注册，具有独立法人资格，财务会计制度健全，依法纳税。

（二）不违反国家、省、市联合惩戒政策和制度规定，近三年无不良信用记录，符合国家、省、市能耗、环保、安全生产、产品质量等要求。

（三）有完整的全职研发团队，具备自主研发能力。

第五条 本办法所称集成电路设计企业，需同时符合下列条件：

（一）符合本办法第四条规定，以集成电路设计为主营业务。

（二）拥有自主知识产权，并以此为基础开展经营活动。

（三）具有与集成电路设计相适应的生产经营场所、软硬件设施等开发环境（如电子设计自动化（**EDA**）工具、合法的开发工具等），以及与所提供服务相关的技术支撑环境。

第六条 本办法重点支持方向为：

（一）存储器方向。围绕存储器及控制器芯片的产业链。

（二）光电子方向。包括 **5G** 及通信芯片、新型显示芯片、红外探测芯片、**LED** 驱动芯片及相关模块的集成电路产品。

（三）新兴产业方向。物联网、人工智能、智能终端、信息安全、北斗导航、汽车电子、生物医疗电子等领域的芯片。

（四）其它技术方向。微控制器（含精简指令集（**RISC-V**）架构）、第三代化合物半导体、功率半导体、模拟及数模混合电

路、微机电系统（MEMS）、射频电路、先进封装、半导体高端设备及材料、大尺寸硅片等。

第三章 职责分工

第七条 本办法涉及市经信局、各区（开发区）经信部门、第三方专业机构、申报企业等单位，各自承担以下主要职责：

（一）市经信局：编制年度资金预算和三年支出规划，发布资金申报通知，指导各区（开发区）经信部门开展项目申报和评审。开展项目跟踪管理、监督检查，办理资金拨付；按照政府采购的相关规定统一选聘第三方专业机构开展项目申报和审核等过程中的事务性和辅助性工作；开展资金项目绩效自评，配合市财政局进行重点评价或再评价，配合审计、监察等部门对资金使用和管理进行监督检查；职能范围内的其他工作事项。

（二）各区（开发区）经信部门：负责项目的申报、受理、核查、认定、资金分配和监督使用等，负责组织对辖区内项目进行第三方专业机构（由市经信局统一选聘）审核，加强项目资金使用安全和效益目标的跟踪管理，抓好项目落地建设和政策落实。

（三）第三方专业机构：受市经信局委托，承担项目申报、审核、后评价等过程中的事务性和辅助性工作。

（四）项目申报企业（单位）：按照申报通知要求提交专项资金项目申请书等资料；按照要求开展绩效自评工作，配合开展监督、检查工作；及时报送项目有关材料，并对材料的真实性、准确性和完整性负责；根据项目评价结果及时调整。

第四章 申报条件和资助标准

第八条 流片补贴（武政规〔2020〕18号文第四条）申报条件、申报资料和资助标准：

（一）符合本办法第五条规定且符合下列条件的企业可申请流片补贴：

1.企业年度进行全掩膜（**Full Mask**）或多项目晶圆（**MPW**）首轮流片的。

2.经过**Full Mask**流片，达到设计要求后，可以提供给集成电路系统整机厂商进行芯片性能测试及示范应用的芯片产品，产品须获得集成电路布图设计登记证书。

3.“首轮流片”是指集成电路设计企业为某款芯片进行的第一次流片。

4.流片费用具体包括：掩膜版制作费、用于首轮流片的晶圆购置费（不高于**25**片晶圆）、制造端**IP**授权费、测试加工费等。

（二）申报流片补贴的企业应提供下列申报材料：

1.企业营业执照复印件。

2.全掩膜（**Full Mask**）首轮工程产品流片、多项目晶圆（**MPW**）流片的情况说明。

3.企业上一年度财务审计报告及相关财务资料（包括：企业**Full Mask**流片中掩膜版制作费用或首轮流片费用的材料；企业**MPW**流片中首轮流片费用的材料；集成电路设计企业与集成电路制造企业签订的**Full Mask**、**MPW**首轮流片合同、发票、转账凭证等相关材料）。

- 4.盖章的申报材料真实性及不重复申请承诺书。
- 5.企业曾获得市级相关财政资金支持明细的文件。
- 6.市经信局要求的其他材料。

（三）流片补贴标准：

1.对完成全掩膜（**Full Mask**）首轮工程产品流片的集成电路设计企业，给予首轮流片费用 **30%**或首轮掩膜版制作费用 **50%**的补贴，单个企业年度补贴总额最高 **500** 万元。

2.对使用多项目晶圆（**MPW**）流片进行研发的集成电路设计企业，给予 **MPW** 首轮流片费用 **50%**的补贴，单个企业年度补贴总额最高 **100** 万元。

第九条 设计费用补贴（武政规〔2020〕18号文第五条）
申报条件、申报资料和资助标准：

（一）符合本办法第五条规定且符合下列条件的企业可申请设计费用补贴：

- 1.企业年度直接购买 **IP**、**EDA** 并用于研发。
- 2.企业年度复用、共享我市第三方集成电路（**IC**）设计平台的 **IP** 设计工具软件或测试分析系统。
- 3.购买 **IP** 不包含委托技术服务。
- 4.“**IP**”是指供应方提供的已形成知识产权并完成权属登记的，可直接用于二次开发的商品。“**Foundry IP**”指由代工厂提供的用于流片环节的 **IP** 模块。

5.“委托技术服务”是指，委托方提出技术需求，由供应方研发，之后就该项技术形成知识产权，权属由双方自行约定的。

（二）申报设计费用补贴的企业应提供下列申报材料：

1.企业营业执照复印件。

2.企业购置 IP、EDA 的情况介绍；企业开展复用、共享我市第三方 IC 设计平台的 IP 设计工具软件或测试分析系统的工作情况介绍。

3.企业上一年度财务审计报告及相关财务资料（包括：企业购置 IP、EDA 的费用明细表、合同、发票、转账凭证等；企业开展复用、共享我市第三方 IC 设计平台的 IP 设计工具软件或测试分析系统的费用明细表、合同、发票、转账凭证等）。

4.盖章的申报材料真实性及不重复申请承诺书。

5.企业曾获得市级相关财政资金支持明细的文件。

6.市经信局要求的其他材料。

（三）设计费用补贴标准：

1.给予购买 IP、EDA 实际支出费用的 30%、年度总额最高 200 万元的补贴。

2.给予复用、共享我市第三方集成电路设计平台的 IP 设计工具软件或者测试分析系统实际投入的 50%、年度总额最高 100 万元的补贴。

第十条 集成电路公共服务平台建设资助和运营奖励（武政规〔2020〕18 号文第六条）申报条件、申报资料和资助标准：

（一）符合本办法第四条规定且符合下列条件的企业可申请集成电路公共服务平台建设资助和运营奖励：

1.经市级以上（含）科技、发改、经信部门认定的，提供 EDA 工具和 IP 核、设计解决方案、先进工艺流片、先进封测服务、测试验证设备等用于我市企业芯片研发支撑服务的。

2.正常运营服务，具有明确的发展规划、功能定位和管理机制，拥有相应的服务设施、专业技术和管理人才队伍；主要面向中小型集成电路设计企业提供服务，具有公共性、开放性和资源共享性。

3.申报企业投入平台建设和运营的自有资金不低于总投资的 30%，且有能为平台的后续建设提供资金；政府补贴资金不得用于流动资金和纳入财政经费保障人员的工资性支出。

（二）申报集成电路公共服务平台建设资助和运营奖励的企业应提供下列申报材料：

1.企业营业执照复印件。

2.平台基本情况、发展规划、功能定位、运营管理制度等相关文件。

3.平台取得经营资质的文件和证明材料，知识产权证，检测报告，获奖证书，国家、省市有关平台项目批复文件、合作协议，团队人员情况等相关证明材料。

4.平台年度为我市集成电路企业提供公共技术服务的企业名单及相关合同、发票、转账凭证等材料复印件。

5.平台上一年度财务审计报告，企业上一年度财务审计报告。

6.盖章的申报材料真实性及不重复申请承诺书。

7.平台曾获得市级以上(含)相关财政资金支持明细的文件。

8.企业曾获得市级相关财政资金支持明细的文件。

9.市经信局要求的其他材料。

（三）集成电路公共服务平台建设资助和运营奖励标准：

1.对新建的集成电路公共服务平台，一次性给予平台实际建设投入自有资金部分 **30%**的资助，最高资助总额不超过 **1000** 万元。

2.对投入运营的集成电路公共服务平台，按年度市内中小企业服务合同实际完成额的 **30%**给予奖励，单个平台每年最高不超过 **500** 万元。

第十一条 销售自主研发设计的芯片及相关产品奖励（武政规〔**2020**〕**18**号文第七条）申报条件、申报资料和资助标准：

（一）符合本办法第四条规定且符合下列条件的企业可申请销售自主研发设计的芯片及相关产品奖励：

1.芯片及相关产品指以下四类产品：芯片、集成电路制造或测试设备、集成电路制造材料、**EDA** 软件。

2.企业销售自主研发设计的芯片，且单款芯片年度销售金额累计超过 **500** 万元的（依据会计准则核算）。

3.企业销售自主研发设计、生产制造的集成电路设备或材料，且单款产品年度销售金额累计超过 **300** 万元的（依据会计准则核算）。

4.企业年度销售自主研发设计的 **EDA** 软件产品。

5.企业销售的芯片及相关产品须拥有自主知识产权（包括专利权、集成电路布图设计专有权等）。

6.是否单款芯片、设备、材料、**EDA** 软件，以名称、型号以及其他相关技术材料判定。

7.单个企业同一类产品销售奖励只支持一次。

（二）申报销售自主研发设计的芯片及相关产品奖励的企业

应提供下列申报资料：

- 1.企业营业执照复印件。
- 2.企业上一年度财务审计报告。
- 3.所售芯片、设备、材料、**EDA** 软件的情况介绍。
- 4.所售芯片、设备、材料、**EDA** 软件专利证书或知识产权相关证明材料。
- 5.芯片、设备、材料、**EDA** 软件的销售合同、货款到帐凭证和销售发票复印件。
- 6.盖章的申报材料真实性及不重复申请承诺书。
- 7.企业曾获得市级相关财政资金支持明细的文件。
- 8.市经信局要求的其他材料。

（三）销售自主研发设计的芯片及相关产品奖励标准：

1.对于企业销售自主研发设计的芯片，且单款芯片年度销售金额累计超过 **500** 万元的，按照年度销售金额 **10%** 给予一次性奖励，单款芯片年度奖励最高不超过 **500** 万元。单个企业年度奖励总额最高不超过 **1000** 万元。

2.企业销售自主研发生产的集成电路关键核心设备或材料，且单款设备或材料年度销售金额累计超过 **300** 万元的，按照年度销售金额 **30%** 给予一次性奖励，单款设备或材料年度奖励最高不超过 **500** 万元。单个企业年度奖励总额最高不超过 **1000** 万元。

3.企业销售自主研发 **EDA** 软件，按照单款 **EDA** 软件年度销售金额 **50%** 给予一次性奖励，单款 **EDA** 软件年度奖励最高不超过 **500** 万元。单个企业年度奖励总额最高不超过 **1000** 万元。

第十二条 企业贷款贴息（武政规〔2020〕18号文第九条）
申报条件、申报资料和资助标准：

（一）符合本办法第四条规定且符合下列条件的企业可申请企业贷款贴息：

1.企业年度为扩大研发、生产而新增的银行商业贷款，不包括企业获得的政策性银行贷款。

2.企业上一年度的集成电路主营业务收入占企业收入总额的比例不低于**60%**。

（二）申报企业贷款贴息的企业应提供下列申报资料：

1.企业营业执照复印件。

2.企业上一年度财务审计报告。

3.企业经营和技术研发基本情况及年度新增贷款资金为扩大研发、生产的情况说明。

4.企业支付银行贷款利息凭证，借款合同、借款凭证或贷款进账单、银行借款利息结算凭证复印件。

5.申报企业对申报材料的真实性及不重复申请承诺书。

6.企业曾获得市级相关财政资金支持明细的文件。

7.市经信局要求的其他材料。

（三）企业贷款贴息标准：

1.按年度新增贷款的实际贷款利率的**50%**给予贷款贴息，单个企业每年贴息金额最高不超过**1000**万元。

2.“按实际贷款利率的**50%**给予贷款贴息”仅针对企业年度实际支付银行贷款利息金额的**50%**给予贷款贴息。

3.新增贷款是指年度内新核准并已发放的贷款。

4.对因逾期、违约等产生的费用一律不予补贴。

第十三条 本办法所称“申报资料”是指企业申报专项资金需提供的基本材料，申报时市经信局可在申报受理通知中要求提供其他必要的申报材料。当某项申报材料中合同、发票、转账凭证中的金额不一致时，以转账凭证中的实际金额为准。本办法所称“年度”起止时间以当年申报通知的起止结算时间为准。本办法对关联公司虚假的、不公允的关联交易不予支持。

第五章 资金申报与审核

第十四条 资金的申报流程

（一）发布通知。市经信局每年定期发布资金申报通知。

（二）组织申报。各区（开发区）经信部门在本辖区范围内转发市经信局通知，并组织企业开展相关申报工作。

第十五条 资金的审核流程

（一）受理初审。各区（开发区）经信部门按照本办法对企业申报材料的合规性、真实性、完整性进行初审。申报材料不全、不符合申报条件的不予受理。

（二）查重。由各区（开发区）经信部门协请本区财政部门，对申报项目是否通过其它渠道获得过市级财政支持进行审核，对有异议的申报企业，取消本年度申报资格。

（三）第三方专业机构评审。市经信局统一选聘 **1** 家第三方集成电路专业咨询机构和 **1** 家第三方审计机构。各区（开发区）经信部门根据选聘结果，组织开展对项目的第三方专业机构评审，由选聘产生的 **2** 家第三方专业机构联合开展下述评审工作：

1.第三方集成电路专业咨询机构邀请集成电路产业专家，会同第三方审计机构，对申报企业是否符合申报条件开展专项评审；

2.第三方审计机构，会同集成电路产业专家，对申报企业的项目实际发生费用进行专项审计；

3.集成电路产业专家，会同第三方审计机构，针对符合条件的集成电路企业，进行现场实地核查；

（四）项目拟定。由各区（开发区）经信部门依据第三方专业机构的评审意见和审计报告，按照支持标准确定本辖区资金拟支持的项目及金额并进行公示，时间不少于 5 个工作日。对有异议的申报企业，取消本年度申报资格。

（五）资金申请。由各区（开发区）经信部门汇总本辖区资金拟支持的项目及金额，编制年度奖补资金支持方案，提出各区年度资金申请额度并正式行文上报至市经信局，上报需提供的资料：专项申请报告文件、项目审核程序清单、第三方专业机构关于项目的总体报告。

第六章 资金计划与拨付

第十六条 资金的计划与拨付流程

（一）资金计划。市经信局依据年度资金预算控制数和各区资金申请额度，按照相同支持条件和奖补标准，制定资金切块分配的预安排计划，会商市财政部门后报局长办公会及党组会审定，形成年度资金预算计划报送市财政局。

（二）计划下达。市经信局按照市财政专项资金管理的相关

要求将资金切块下达到各区经信部门，各区经信部门负责资金细化到具体项目，并予以公示接受社会监督，时间不少于5个工作日。

（三）资金拨付。市经信局根据年度预算批复，会同市财政部门，按照相关规定将资金转移支付至各区。各区经信部门及时将资金拨付至项目承担企业。

第七章 监督检查与绩效管理

第十七条 各区（开发区）经信部门作为操作主体，对申报企业的相关资料审查的合规性、真实性、完整性负责，对获准支持的项目做好服务协调工作，并将相关申报资料建立专项档案备查。

第十八条 申报企业（单位）应遵循诚实信用原则如实申报，若发现申报材料弄虚作假的取消申报资格，已获得专项资金的收回资金，并在今后五年内不再受理该企业的申报。

第十九条 市经信局会同市财政部门对各区（开发区）经信部门申报程序加强监督检查，并适时进行抽查。如发现违规操作，及时纠正，涉嫌犯罪的，依法追究相关单位及人员法律责任。

第二十条 市经信局按照财政部门有关规定，委托第三方专业机构对项目资金投入使用、项目运行管理措施、绩效目标的实现程序和效果等进行专项评估，并出具书面评价意见。

第八章 附 则

第二十一条 同一支持对象因同样或类似原因可同时享受

市级多项政策，或同一事项符合本办法多项条款的，按就高、不重复原则落实。享受市级“一事一议”政策的集成电路企业，不再享受本办法。

第二十二条 本办法由市经信局负责解释，自 2021 年 5 月 8 日起实施，有效期 5 年。